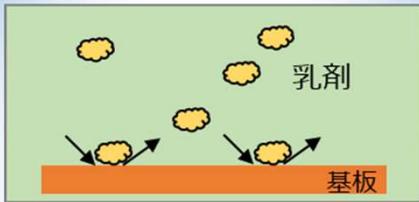


サテン調めっき

KASUMIプロセス

エマルジョン法 (1段処理)

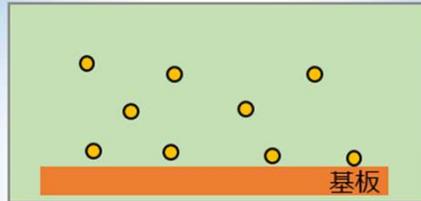


乳剤が表面に付着→脱離



めっき析出が阻害され
半円状のくぼみができる

コンポジット法 (1段処理)

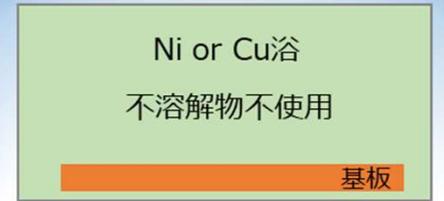


微粒子が付着



微粒子が共析

KASUMI (2段処理)



浴管理は汎用の電気めっきと同じ



汎用の電気めっき



< 下地: Ni >



< 下地: Cu >

カバー
めっき



< Ni / Cr >

- 界面活性剤や微粒子を含まず管理が容易
- 特別な設備は不要
- 浴寿命が長く経済的